

证券代码：688662

证券简称：富信科技

公告编号：2026-038

广东富信科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富信科技”），编制了截至2026年6月30日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕552号文同意注册，公司于中国境内首次公开发行A股股票，并于发行完成后在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行A股股票2,206.00万股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币15.61元，收到股东认缴股款共计人民币344,356,600.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币307,574,668.46元，募集资金于2021年3月29日到账。

上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具众环验字〔2021〕0500004号验资报告验证。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户行	账号	初始存放金额（元）	截止日余额	备注
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂容奇支行	801101001220985617	138,389,000.00	0.00	已销户
中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行	2013014429200065552	0.00	0.00	

开户行	账号	初始存放金额（元）	截止日余额	备注
中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行	2013012929020251673	127,843,204.00	0.00	已销户
中国农业银行股份有限公司顺德容里支行	44492701040022475	55,463,000.00	0.00	
合计		321,695,204.00（注）	0.00	

注：账户初始存放金额系保荐机构（主承销商）中泰证券股份有限公司将扣减承销费和保荐费后的资金净额，共计 321,695,204.00 元（包含未支付的其他发行费用 14,120,535.54 元），截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金专项账户余额为零元。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照情况

根据公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书披露的募集资金运用方案，公司前次募集资金扣除发行费用后，将用于“半导体热电器件及系统产业化升级项目”“半导体热电整机产品产能扩建项目”“研发中心建设项目”和“补充流动资金”。

截至 2026 年 6 月 30 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前次募集资金使用情况对照表”。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司前次募集资金未发生实际投资项目变更情况。

1、调整募投项目拟投入募集资金及增加募投项目实施主体情况

2021 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过《关于增加部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本的议案》，具体情况如下：

（1）调整募投项目拟投入募集资金情况

由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 30,757.47 万元，低于原计划拟投入募集资金金额 50,290.88 万元。公司根据生产经营需要，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，按照轻重缓急顺序投入以下项目建设：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	调整前拟使用 募集资金	调整后拟使用 募集资金
1	半导体热电器件及系统产业化升级项目	13,838.90	13,838.90	13,838.90
2	半导体热电整机产品产能扩建项目	15,905.68	15,905.68	11,372.27
3	研发中心建设项目	5,546.30	5,546.30	5,546.30
4	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	-
合计		50,290.88	50,290.88	30,757.47

（2）增加募投项目实施主体情况

基于推进项目建设的需要，公司增加全资子公司广东富信热电器件科技有限公司（以下简称“富信器件”）作为“半导体热电器件及系统产业化升级项目”中“高端半导体热电器件项目”子项目的实施主体，并使用募集资金 5,500.00 万元向富信器件增资。“半导体热电器件及系统产业化升级项目”项目中“普通半导体热电器件及系统产业化升级项目”子项目仍由公司实施。

上述调整是基于公司推进募投项目建设的需要，未改变募集资金的用途，具体内容详见公司 2021 年 8 月 20 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2021-028）。

2、变更募投项目实施地点，使用自有资金追加投资及募投项目延期情况

2022 年 3 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，2022 年 4 月 22 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金追加部分募投项目投资暨部分募投项目变更实施地点及延期的议案》，具体情况如下：

（1）变更募投项目实施地点

为保证公司未来发展战略规划得以实施，公司将原募投项目“半导体热电器件及系统产业化升级项目”中的“普通半导体热电器件及系统产业化升级项目”、“半导体热电整机产品产能扩建项目”和“研发中心项目”的实施场地由佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路 20 号变更至容桂华口居委会华发路以东、昌业路以南地块，原募投项目的产品、产能等保持不变。

(2) 使用自有资金追加投资

因上述募投项目变更实施地点，需增加土建等投入，公司使用自有资金9,040.44万元对部分募投项目增加投资，使用募集资金的金额未发生变化，具体情况如下：

单位：万元

募投项目名称		实施地点	原总投资额	现拟投入总金额	拟使用募集资金
半导体热电器件及系统产业化升级项目	普通半导体热电器件及系统产业化升级项目	容桂华口居委会华发路以东、昌业路以南地块	8,338.90	11,057.10	8,338.90
	高端半导体热电器件项目	佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路20号	5,500.00	5,500.00	5,500.00
半导体热电整机产品产能扩建项目		容桂华口居委会华发路以东、昌业路以南地块	15,905.68	17,806.15	11,372.27
研发中心建设项目		容桂华口居委会华发路以东、昌业路以南地块	5,546.30	9,968.06	5,546.30
合计			35,290.88	44,331.32	30,757.47

(3) 募投项目延期

因“普通半导体热电器件及系统产业化升级项目”和“半导体热电整机产品产能扩建项目”变更实施地点，土建工程量大，建设周期长；“高端半导体热电器件项目”因产品开发技术难度大，且需根据不同客户需求进行个性化开发，总体达产周期长，公司将募投项目进行延期，具体情况如下：

募投项目名称		调整前预计达到可使用状态日期	调整后预计达到可使用状态日期	延期原因
半导体热电器件及系统产业化升级项目	普通半导体热电器件及系统产业化升级项目	2023.3.31	2024.3.31	因项目变更了实施地点，新地点的土建工程量大，建设周期长。
	高端半导体热电器件项目	2023.3.31	2024.3.31	因产品开发技术难度大，且需根据不同客户需求进行个性化开发，总体达产周期延长。

募投项目名称	调整前预计达到可使用状态日期	调整后预计达到可使用状态日期	延期原因
半导体热电整机产品产能扩建项目	2023.3.31	2024.3.31	因项目变更了实施地点，新地点的土建工程量大，建设周期长。

上述调整是基于公司推进募投项目建设的需要，未改变募集资金的用途，具体内容详见公司 2022 年 3 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用自有资金追加部分募投项目投资暨部分募投项目变更实施地点及延期的公告》（公告编号：2022-013）。

3、调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期情况

2024 年 3 月 25 日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，2024 年 4 月 18 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及延长实施期限的议案》，具体情况如下：

（1）调整部分募投项目内部投资结构

为进一步提高募集资金使用效率，更加科学安排和调动资源，综合考虑最新的市场环境、各募投项目建设实施情况以及未来资金投入规划，公司拟在募集资金投资用途、投资总额、投资目标均不变的前提下，对“半导体热电整机产品产能扩建项目”“研发中心建设项目”的内部投资结构进行调整，具体情况如下：

①半导体热电整机产品产能扩建项目

单位：万元

序号	费用名称	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额	本次增减情况
1	建筑工程投资	2,076.80	6,076.80	4,000.00
2	设备购置及安装	6,012.09	3,612.09	-2,400.00
3	基本预备费	631.12	631.12	-
4	铺底流动资金	2,652.26	1,052.26	-1,600.00
合计		11,372.27	11,372.27	-

②研发中心建设项目

单位：万元

序号	费用名称	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额	本次增减情况
1	建筑工程投资	-	600.00	600.00
2	设备购置及安装	3,576.30	2,976.30	-600.00
3	研发人工投资	1,120.00	1,120.00	-
4	研发实施费用	850.00	850.00	-
合计		5,546.30	5,546.30	-

(2) 募投项目延期情况

鉴于部分募投项目实施地点变更后的场地整体建设工程量大、建设标准高，建设周期较长，消费类市场处于缓慢复苏状态，募投项目的建设进度有所延后，公司决定对募投项目预计达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

序号	项目名称	调整前预计达到预定可使用状态	调整后预计达到预定可使用状态
1	半导体热电器件及系统产业化升级项目	2024.3.31	2026.3.31
2	半导体热电整机产品产能扩建项目	2024.3.31	2026.3.31
3	研发中心建设项目	2024.3.31	2026.3.31

上述调整未改变募投项目实施主体以及募集资金投入总额，不存在变相改变募集资金投向的情形，具体内容详见公司 2024 年 3 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整部分募投项目内部投资结构及延长实施期限的公告》（公告编号：2024-015）。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异情况如下：

单位：万元

投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
半导体热电器件及系统产业化升级项目	13,838.90	13,838.90	12,232.40	-1,606.50	(注)
半导体热电整机产品产能扩建项目	15,905.68	11,372.27	9,280.41	-2,091.86	(注)
研发中心建设项目	5,546.30	5,546.30	4,654.08	-892.22	(注)
补充流动资金	15,000.00				
合计	50,290.88	30,757.47	26,166.90	-4,590.57	

注：在募投项目建设过程中，公司在保证项目建设进度和质量的前提下，本着专款专用、合理节约、降本增效的原则，加强项目各个环节费用的控制和管理，对各项资源进行合理调度，合理降低项目建设相关成本和费用，形成承诺投资资金和实际投资资金的差异。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在对外转让前次募集资金投资项目的情形。公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情形，具体如下：

2021年5月20日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币40,131,404.05元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。上述募集资金置换情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《关于广东富信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》（众环专字〔2021〕0500109号）。

（五）闲置募集资金使用情况说明

为了提高公司募集资金的使用效率，增加资金收益，保持资金流动性，公司对闲置募集资金进行了现金管理，具体情况如下：

公司于2021年4月21日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币24,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品（包括银行理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2022年3月25日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币24,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2023年4月26日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币24,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于结

构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

公司于 2024 年 3 月 25 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的保本型产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月。

公司于 2025 年 3 月 19 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 12,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的保本型产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0.00 元。

（六）尚未使用的前次募集资金情况

2026 年 3 月 18 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“半导体热电器件及系统产业化升级项目”“半导体热电整机产品产能扩建项目”“研发中心建设项目”结项，并将截至 2026 年 2 月 28 日的节余募集资金 6,100.30 万元（含利息及现金管理收益净额及尚未支付的款项，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金（资金转出当日专户余额为 6,467.44 万元，包括项目节余归集的募集资金 4,590.57 万元及其银行理财收益及利息 1,876.87 万元）。2026 年 3 月 18 日，公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具《关于广东富信科技股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金无异议。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司前次募集资金已按计划全部使用完毕。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

前次募集资金投资项目实现效益情况详见“附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”，对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“研发中心建设项目”无法单独核算效益。该项目的实施系对公司现有研发能力和科技创新能力的有效加强，项目本身不产生直接的经济效益，但能够进一步巩固和提高公司的核心竞争力。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

不适用。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

公司前次募集资金使用不涉及以资产认购股份的情形。

四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

五、结论

董事会认为，公司已按照招股说明书及后续经审议调整后的募集资金投资计划使用前次募集资金，并对前次募集资金的使用投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 23 日

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额			30,757.47(注 1)			已累计使用募集资金总额			26,166.90	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			26,166.90	
						其中：2026 年 1-6 月			288.43	
变更用途的募集资金总额比例			-			2025 年			3,421.89	
						2024 年			6,063.13	
						2023 年			8,370.39	
						2022 年			3,366.93	
						2021 年			4,656.13	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	半导体热电器件及系统产业化升级项目	半导体热电器件及系统产业化升级项目	13,838.90	13,838.90	12,232.40	13,838.90	13,838.90	12,232.40	-1,606.50	2026 年 3 月 31 日(注 2)

2	半导体热 电整机产 品产能扩 建项目	半导体热电 整机产品产 能扩建项目	15,905.68	11,372.27	9,280.41	15,905.68	11,372.27	9,280.41	-2,091.86	2026 年 3 月 31 日(注 2)
3	研发中心 建设项目	研发中心建 设项目	5,546.30	5,546.30	4,654.08	5,546.30	5,546.30	4,654.08	-892.22	2026 年 3 月 31 日(注 2)
4	补充流动 资金	补充流动资 金	15,000.00	--	--	15,000.00	--	--	--	不适用
合计			50,290.88	30,757.47	26,166.90	50,290.88	30,757.47	26,166.90	-4,590.57	

注 1：本附件 1 中的“募集资金总额”为扣除发行费用后的实际募集资金总金额。

注 2：2024 年 3 月 25 日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及延长实施期限的议案》，同意将“半导体热电器件及系统产业化升级项目”、“半导体热电整机产品产能扩建项目”、“研发中心建设项目”三项募投项目的预计达到预定可使用状态日期由原定的 2024 年 3 月 31 日延长至 2026 年 3 月 31 日。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目			截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称				2023 年度	2024 年度	2025 年度	2026 年 1-6 月		
1	半导体热电器件及系统产业化升级项目	半导体热电器件	82.62%	3,940.19(注 1)	-194.52	628.82	1,789.19	2,315.15	5,777.43	不适用(注 3)
		热电系统	57.65%							
2	半导体热电整机产品产能扩建项目		不适用	3,572.10(注 2)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用(注 3)
3	研发中心建设项目		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：根据招股说明书，项目达产后，预计项目年均营业收入 24,400.00 万元，净利润 3,940.19 万元；

注 2：根据招股说明书，项目达产后，预计项目年均营业收入 27,750.00 万元，净利润 3,572.10 万元；

注 3：半导体热电器件及系统产业化升级项目、半导体热电整机产品产能扩建项目在 2026 年 3 月达到预定可使用状态，2026 年 4 月至 6 月并不构成完整会计年度，故不适用承诺效益评价。